

FusionServer

X6000 V6高密度サーバー



X6000 V6高密度サーバー

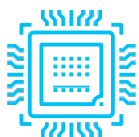


X6000 V6(8ハードディスク)



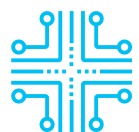
X6000 V6(24ハードディスク)

FusionServer X6000 V6(以下「X6000 V6」という)は、ISPとHPC顧客の大規模なサーバー展開のニーズを満たすために、アーキテクチャを最適化して開発した、次世代の2U高密度サーバーです。インターネット、HPC、クラウドコンピューティング、データセンターなどのサービスのニーズにお応えします。X6000 V6は、ソフトウェア・デファインド・ストレージ(SDS)、ビッグデータとソフトウェア・デファインド・インフラストラクチャ(SDI)アーキテクチャに適します。



高密度な計算、優れた性能

- 従来の1Uラックサーバーの2倍、従来の2Uラックサーバーの4倍のコンピューティング密度を提供
- 最大24台のNVMe SSDをサポート



統合管理、容易な保守

- ブレードとラックサーバーの両方の利点を備えた各ノードのiBMCによる連携管理方式を採用。ノードを背面に搭載し、ケーブルを背面から配線
- モジュラーデザインを採用。ハードディスク、ノード、電源、OCPカードとファンモジュールがホットスワップ対応で、大幅なO&M効率向上を実現



共有アーキテクチャ、効率的な省エネ

- サーバーノードが4台の1+1または2+2冗長対応の電源モジュールを共有。シャーシ全体が最大4台の3000W電源モジュールをサポート
- ハードディスク接続がバックプレーンなしの設計を採用することで、20%のシステム放熱性能向上を実現
- 相変化均一温度ペイパーチャンパー(VC)技術を採用した大型VC結合ヒートシンクを搭載することで、15倍以上の熱伝導率向上を実現

形態	2U4ノードシャーシ
サーバーノード	4台の1Uハーフワイド2ソケットサーバーノード
電源モジュール	4台の1200W、1500W、2000Wまたは3000W AC電源モジュール、1+1または2+2 冗長*とホットスワップ対応
電力供給	100～240V AC、240V DC
ファンモジュール	4台の8080+ファンモジュール、N+1冗長とホットスワップ対応
動作温度	5° C～45° C (ASHRAE Class A1/A2/A3/A4に準拠)
認証	CE、UL、FCC、CCC、VCCI、RoHS
寸法(幅×奥行×高さ)	447mm×899mm×86.1mm

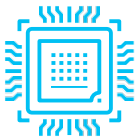
*サーバー全体の消費電力と単一電源の電力に応じて、X6000は1+1または2+2冗長の電源構成をサポートします。

XH321 V6サーバーノード



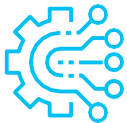
XH321 V6

FusionServer XH321 V6(以下「XH321 V6」という)は、xFusionがエネルギーの制約を打ち破り、システムのストレージ密度を高めるために革新的に設計した、次世代の1U ハーフワイド2ソケットサーバーノードです。XH321 V6は、優れた計算能力、極めて高いストレージ密度、容易な管理、容易な保守などの特長を備え、データセンター、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、インターネットなどの運用シナリオに適します。



優れた計算性能

- 最大2基の第3世代インテル® Xeon® スケーラブルプロセッサを搭載でき、最大TDP 270Wに対応
- 8つのメモリーチャンネルに対応し、45%のメモリー帯域幅向上を実現
- フルNVMe SSD構成による高速化と2+4のロードバランス構成により、I/Oボトルネック排除を実現



柔軟な展開

- InfiniBand HDR 200高速ネットワーク相互接続に対応
- 2台のM.2 SSDに対応し、高速で信頼性の高いOS起動ディスクを提供

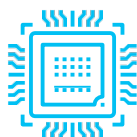
形態	1Uハーフワイド2ソケットサーバーノード
プロセッサ	2基の第3世代インテル® Xeon® スケーラブルプロセッサ(6300/8300シリーズ)、最大TDP 270W対応
メモリー	16枚の最大3200MT/sのDDR4 DIMM、最大2TBのメモリー容量(128GBメモリー搭載時)対応
ローカルストレージ	最大6台の2.5インチSAS/SATA/SSD/NVMeハードディスクに対応 2+4ロードバランスのNVMe構成に対応 最大2台のM.2 2280または2242 SATA SSDに対応 異なるタイプのハードディスクの混合構成に対応
RAIDサポート	RAID0、1、5、6、10、50、60、およびスーパーキャパシタによる電源障害保護に対応 M.2 SSDによるRAID0、1の構築に対応
PCIe拡張	最大2つのPCIe 4.0x16ハーフハイトハーフレングスの標準PCIeスロット
OCP拡張	1つのOCP拡張スロット
管理	- iBMCチップは、1つの管理用GEネットワークポートを統合。故障診断、自動O&M、ハードウェアセキュリティ強化などの包括的な管理機能を提供 - iBMCは、Redfish、SNMP、IPMI 2.0などの標準インターフェースに対応。HTML5/VNC KVMに基いたリモート管理ユーザーインターフェースを提供し、管理の複雑さを簡素化するCD-ROM不要な展開とエージェントレスの特性をサポート 1つの統合管理ポートを提供することで、4台のサーバーノードを1つの管理ポートに集約して管理の簡素化を実現 - オプションのFusionDirector管理ソフトウェアは、ステートレスコンピューティング、パッチOS展開、ファームウェア自動アップグレードなどの高度な管理機能を提供し、ライフサイクル全体にわたるインテリジェント化・自動化された管理を実現
OS	Microsoft Windows Server、SUSE Linux Enterprise Server、VMware ESXi、Red Hat Enterprise Linux、CentOS、Oracle、Ubuntu、Debian
動作温度	5° C~45° C(ASHRAE Class A1/A2/A3/A4に準拠)
認証	CE、UL、FCC、CCC、VCCI、RoHS
寸法(幅×奥行×高さ)	218.7mm×632mm×40.7mm

XH321C V6水冷サーバーノード



XH321C V6

FusionServer XH321C V6は、次世代の1Uハーフワイド2ソケット水冷サーバーノードです。CPUとメモリーの水冷(45° C温水対応)をサポートします。キャビネットレベルの完全な水冷ソリューションにより、100%の熱放散率と1.05以下の電力使用効率(Power Usage Effectiveness、PUE)を実現し、ボードレベルの水冷ソリューションにより、80%の熱放散率と1.1以下のPUEを実現します。



高エネルギー効率、高信頼性

- CPUはマイクロチャンネルコールドプレートを採用し、メモリー間のコールドプレートは最適化された水路設計を採用することで、80%のボードレベル水冷率を実現
- 45° C温水冷却に対応し、TCOを20%削減
- 回路から隔離されたシステム水路設計を採用し、異常状態を監視可能



キャビネットレベルの展開

- FusionServer水冷キャビネットに収容。キャビネット内にmanifoldを統合しており、メインパイプとの迅速な接続を実現
- 水冷キャビネットに最大72台の水冷サーバーノードを搭載可能

形態	1Uハーフワイド2ソケット水冷サーバーノード
プロセッサ	2基の第3世代インテル® Xeon® スケーラブルプロセッサ(6300/8300シリーズ)、最大270W対応
メモリー	16枚の最大3200MT/sのDDR4 DIMM、最大2TBのメモリー容量(128GBメモリー搭載時)対応
ローカルストレージ	最大6台の2.5インチSAS/SATA/SSD/NVMeハードディスクに対応 2+4ロードバランスのNVMe構成に対応 最大2台のM.2 2280または2242 SATA SSDに対応 異なるタイプのハードディスクの混合構成に対応
RAIDサポート	RAID0、1、5、6、10、50、60、およびスーパーキャパシタによる電源障害保護に対応 M.2 SSDによるRAID0、1の構築に対応
PCIe拡張	最大1つのPCIe x16ハーフハイトハーフレングスの標準PCIeスロット
OCP拡張	1つのOCP拡張スロット
管理	• iBMCチップは、1つの管理用GEネットワークポートを統合。故障診断、自動O&M、ハードウェアセキュリティ強化などの包括的な管理機能を提供 • iBMCは、Redfish、SNMP、IPMI 2.0などの標準インターフェースに対応。HTML5/VNC KVMに基づいたリモート管理ユーザーインターフェースを提供し、管理の複雑さを簡素化するCD-ROM不要な展開とエージェントレスの特性をサポート • 1つの統合管理ポートを提供することで、4台のサーバーノードを1つの管理ポートに集約して管理の簡素化を実現 • オプションのFusionDirector管理ソフトウェアは、ステートレスコンピューティング、パッチOS展開、ファームウェア自動アップグレードなどの高度な管理機能を提供し、ライフサイクル全体にわたるインテリジェント化・自動化された管理を実現
OS	Microsoft Windows Server、SUSE Linux Enterprise Server、VMware ESXi、Red Hat Enterprise Linux、CentOS、Oracle、Ubuntu、Debian
動作温度	5° C~45° C (ASHRAE Class A1/A2/A3/A4に準拠)
認証	CE、UL、FCC、CCC、VCCI、RoHS
寸法(幅×奥行×高さ)	218.7mm×632mm×40.7mm(冷却水入口と出口のパイプを除く)

xFusion技術日本株式会社

代表電話番号: 03-6206-7368

住所: 〒100-0011 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 日比谷国際ビル 17階

Webサイト: <https://www.xfusion.com/jp/>

Copyrights © xFusion Digital Technologies Co., Ltd. 2022. All rights reserved.

書面によるxFusion Digital Technologies Co., Ltd.の事前承諾なしに、本書のいかなる部分も、いかなる形式またはいかなる手段によっても複製または転載することを禁じます。

商標および許諾

XFUSION およびその他のxFusionの商標は、xFusion Digital Technologies Co., Ltd.の登録商標です。このドキュメントに記載されているその他の商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。

注意

ご購入の製品、サービスおよび機能はxFusion Digital Technologies Co., Ltd.とお客様の間の契約によって規定されます。本文書に記載されている製品、サービスおよび機能の全体または一部は、購入範囲もしくは使用範囲に含まれない場合があります。契約で別途許諾している場合を除き、本文書内の記述、情報、推奨事項はすべて「無保証 (ASIS)」で提供されており、明示的または暗黙的ないかなる保証も約束も行いません。本文書の記載内容は、予告なく変更されることがあります。この文書の作成にあたっては、内容の正確性には最大限の注意を払っておりますが、この文書内のいかなる説明、情報、推奨事項も、明示的または暗黙的に何らかの保証を行うものではありません。